

議題研析

一、題目：歐洲晶片法 2.0 立法政策方向簡介

二、議題所涉法規

無

三、背景說明（緣起）

歐盟執委會正研議推出「歐洲晶片法 2.0」(European Chips Act 2.0, ECA2.0)，期望透過要求各國政府優先採購歐盟新創企業所生產之晶片，扶植歐洲本土半導體產業發展，並降低對美國及東亞晶片供應的依賴¹。此舉係在 2023 年「歐洲晶片法」(ECA) 基礎上進一步推動相關政策，以提升歐洲在半導體領域之自主性與競爭力。

四、問題爭點

歐盟推動相關半導體政策，可能牽動產業發展方向。歐盟及各國未來預計加大投資並建立晶片基金，其補貼規模雖尚未明朗，但可能衍生供應鏈商機；此外，荷蘭主導本次倡議，關鍵設備廠商 ASML 所受出口管制是否鬆動，亦值得關注。另歐盟正與南韓、日本及新加坡推動成熟製程半導體聯合研發計畫，以強化供應鏈韌性，我國未來如何切入相關合作體系，並在國際競合下兼顧科技自主能力與跨區域合作，亦為重要課題²。爰簡介 ECA2.0，作為我國未來規劃產業發展之參考。

¹ 聯合報，扶持自產 歐盟擬推「歐洲晶片法 2.0」 半導體市占率僅 10% 鼓勵政府採購本土新創晶片 降低對外部依賴，115 年 5 月 30 日，第 A9 版。

² 彭瑞怡，歐盟規劃《晶片法案 2.0》政策潛在影響面面觀，台灣經貿網，114 年 10 月 3 日，網址：<https://info.taiwantrade.com/biznews/taiwantrade-3024052.html>，最後瀏覽日期：115 年 6 月 8 日。

五、探討研析

(一) ECA 之困境

雖然 ECA 獲得總計超過 800 億歐元的公共與私人投資，並將半導體議題提升至最高政治層級，但在執行層面上，根據歐盟執委會預測，即便計入已宣布的未來投資，2030 年歐盟在全球晶片市場的占有率僅會從 9.6% 微幅提升至 11.6%，遠低於 20% 的目標。歐盟成員國認為原訂目標過於寬泛且不切實際，缺乏對具體細分市場的戰略聚焦，也因此難以作為資金投入與政策資源配置的依據³。

ECA 未能有效達成政策目標，主要可歸納為以下幾項原因：1. 歐盟執委會權限與資源有限；2. 國際補貼競爭激烈，歐盟投入相對不足；3. 過度偏重供給面措施；4. 市場需求不足影響投資落實⁴。因此，歐盟逐漸意識到，單純透過補貼及擴充產能等供給面措施，未必足以提升歐洲半導體產業競爭力，仍須透過需求創造及市場整合機制提高投資誘因。此亦成為歐盟規劃 ECA2.0 時，轉而更加重視需求面政策與產業應用連結的重要原因。

(二) ECA2.0 政策方向簡介

歐盟刻正研議之 ECA2.0 政策方向，旨在增強歐洲在半導體領域的韌性和科技自主能力。該政策預期將針對歐盟在先進製程半導體節點及其他具競爭優勢晶片市場上製造能力不足的問題提出對策，同時加強半導體市場的監測機制，並簡化相關法制規範⁵。

³ 洪綺臨，歐盟晶片法案 2.0 (上)：從危機應變邁向全球不可或缺的戰略轉型，科技產業資訊室，114 年 11 月 28 日，網址：<https://iknow.stpi.niar.org.tw/post/Read.aspx?PostID=22544>，最後瀏覽日期：115 年 6 月 9 日。

⁴ Niclas Poitiers、Tillman Schenk，Revamping Europe's chips strategy: indispensability, not self-sufficiency，bruegel，2026 年 5 月 13 日，網址：<https://www.bruegel.org/analysis/revamping-europes-chips-strategy-indispensability-not-self-sufficiency>，最後瀏覽日期：115 年 6 月 9 日。

⁵ European Parliament，Chips act 2.0，2026 年 5 月 6 日，網址：[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2026\)785742](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2026)785742)，最後瀏覽日期：115 年 6 月 9 日。

ECA2.0 主要目標如下⁶：

1、改善投資環境與競爭力(improving conditions for investment and competitiveness)

透過強化半導體生態系的研究與創新能力、推動人才培育，並加速行政審核程序(最長12個月完成核准)，以提升投資效率。同時設立「重大挑戰」(grand challenges)，支持AI晶片等關鍵技術發展，並加強與國際夥伴的半導體戰略合作。

2、刺激需求與產業應用(stimulating demand and industrial uptake)

強化晶片製造商與下游產業的連結，建立「需求加速器」(demand accelerators)以加速產品導入市場，並透過公共採購優先創造歐盟附加價值，包括經濟成長與就業機會。此外，推動創新採購以支持新創及成長型企業，並與雲端及AI發展政策結合，以帶動資料中心、雲端服務與AI產業的晶片需求。

3、強化供給面措施(reinforcing supply-side measures)

提供「首創型」(first-of-a-kind)半導體專案的國家補助，並透過戰略專案機制促進歐盟資金投入及會員國與產業共同投資。同時建立有利於半導體投資的區域環境，並設立「半導體卓越區域」(semiconductor regions of excellence)標章，以強化區域發展與投資吸引力。

4、提升韌性與降低依賴(increasing resilience and reducing dependencies)

建立企業對企業的半導體供應鏈平台，以提升供應鏈韌性並強化對供應中斷的預警與應對能力，同時提供風險評估與管理指引，降低

⁶ European Commission, Chips Act 2.0, 2026年6月3日，網址：<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/chips-act-2>，最後瀏覽日期：115年6月9日。

關鍵產業風險暴險程度，並減少對外部供應商在關鍵半導體技術上的依賴，以強化整體供應安全。

（三）結語

ECA2.0 較 ECA 更重視需求面政策，旨在整合分散的市場需求，提高歐洲晶片生產在戰略領域的商業可行性。該政策方向亦建議改革歐盟應對半導體供應鏈危機的方式，強化企業間資訊共享機制，並建立更明確的緊急應變程序。當供應鏈危機發生時，歐盟執委會將可協調聯合採購措施，並要求接受公共補貼之製造業者優先承接相關關鍵訂單⁷。鑑於 ECA2.0 目前仍處於規劃階段，其後續立法進程及政策效果仍有待觀察，我國宜持續掌握相關發展趨勢，評估其對半導體產業及全球供應鏈之影響，並適時調整產業發展與國際合作策略。

撰稿人：林鈺琪

⁷ Luca Bertuzzi, EU seeks to boost Europe's chip demand in tech sovereignty bid, eu ro news, 2026 年 5 月 28 日，網址：<https://www.euronews.com/my-europe/2026/05/28/eu-seeks-to-boost-europes-chip-demand-in-tech-sovereignty-bid>，最後瀏覽日期：115 年 6 月 9 日。